산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	

2017년 10월 27일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 10. 26.(목) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2017. 10. 26.(목)	담당부서	산업통상자원부 전자부품과
담당과장	박영삼 과장(044-203-4270)	담 당 자	이정남 사무관(044-203-4273)

반도체, 상생협력을 통한 재도약 다짐
- 제10회 반도체의 날 기념식 및 상생협력 선언식 개최-

□ 산업통상자원부는 '17.10.26(목) 18:00 서울 코엑스 인터컨티넨탈호텔에서 백운규 산업통상자원부 장관, 박성욱 한국반도체산업협회장(SK하이닉스 부회장) 등 산·학·연 관계자 약 500여명이 참석한 가운데 **'제10회 반도체의 날' 기념식**을 열었다.

* '반도체의 날'은 반도체 수출이 최초로 100억불을 돌파한 '94년 10월을 기념하여 2008년부터 매년 10월 개최

< 행 사 개 요 >

○ **일시 / 장소 :** '17.10.26(목) 18:00~20:00 / 서울 코엑스 인터컨티넨탈호텔
○ **참석자 :** 백운규 산업통상자원부 장관,
박성욱 반도체산업협회장(SK하이닉스 부회장), 산업계 CEO,
반도체산업 유공자 등 약 500여명
○ **주요내용 :** 반도체 상생협력 공동선언식, 유공자 포상(40점)

○ 이번 기념식에서는 우리 경제의 성장을 견인해온 반도체산업의 성과와 위상을 널리 알리고, 반도체 발전에 공적을 남긴 **유공자에 대한 시상식*과 함께,**

* 정부포상(총40점) : (훈장)2, (포장)1, (대통령표창)2, (국무총리표창)3, (산업부장관표창)32

○ 국내 반도체산업 생태계강화를 위해 **반도체 산업계가 상생협력을 결의**하는 **'반도체산업 상생협력 공동선언식'도 개최**했다.

□ **선언식에서는** 삼성전자, 에스케이(SK)하이닉스를 비롯한 반도체 업계가 우리 반도체 산업의 지속적인 성장을 위해 **장비·부품·소재 기업 및 시스템반도체 분야를 공동으로 지원하기로 결의**했다.

○ 먼저, 반도체 산업계 주도로 **반도체 상생협의체를 구성**하고 **반도체 소자·장비기업**이 나서서 부품·소재 등 **반도체 뿌리산업육성**을 위해 **유망품목발굴, 기술개발, 제조, 성능검증 등을 지원**한다.

○ 또한, 시스템반도체 분야 등 창업활성화를 위해 **반도체산업 창업지원센터를 설치**하고 **시제품제작** 등을 지원할 계획이다.

○ 특히, 반도체성장펀드*(총 2,000억 원 규모, 제9회 반도체의 날 양해각서(MOU)체결)가 투자한 기업에 대해서도 반도체 업계가 나서서 연구개발(R&D), 생산·경영 컨설팅 등도 지원하여 **반도체 업계가 펀드를 조성해 투자하고 성장을 지원하는 선순환체계**도 구축한다.

* 반도체성장펀드 : 총 2천억원 규모(삼성전자 500억, SK하이닉스 250억, 성장사다리펀드 750억, 운용사 매칭 500억)로 반도체 분야 중소기업 지원

try of Trade,
try and Energy

□ 산업부 백운규 장관은 축사를 통해, **단일품목 최초 연간 100조 원 수출**을 눈앞에 두고 있는 우리 반도체 산업의 성과를 치하하고, 상생협력에 대한 반도체 업계의 노력에 감사의 뜻을 밝혔다.

○ 특히, **제4차 산업혁명의 도래로** 핵심부품인 반도체 산업에 새로운 기회가 펼쳐지고 있는 상황에서,

○ 반도체 업계가 다짐한 **상생협력 선언**은 우리 **반도체산업이 한단계 더 도약하는 전기**가 될 것이라 밝히며,

○ 정부도 **장비·부품·소재 분야에서 세계적인 중견기업**이 배출 될 수 있도록 정책적 노력과 지원을 아끼지 않겠다고 약속했다.

최미화 / 홍보담당관 / 2017-10-26 11:15:48

□ 아울러, 반도체의 날을 맞아 우리나라 반도체산업 발전에 공적을 남긴 **유공자 40명에 대한 정부 포상**도 진행했다.

○ **은탑산업훈장**은 10나노 및 20나노 디램(DRAM) 개발 및 양산, 세계 최초최대용량의 서버용 메모리 개발 및 초저전력, 세계최대 용량의 모바일 디램(DRAM)을 개발한 공로로 **SK하이닉스 이석희 사장**에게 수여했고,

○ 반도체 모든 공정 장비 국산화 및 세계 최초, 세계 최고의 반도체장비 핵심원천기술을 개발하여 반도체 산업발전에 기여한 **(주)유진테크의 엄평용 대표이사가 동탑산업훈장을,**

○ 10나노급 낸드 세계 최초 상용화 및 '17년 제4세대(64단) 브이(V)낸드의 본격적인 양산화에 성공해 반도체산업 발전에 이바지한 **삼성전자의 임용식 상무가 산업포장**을 받았다.

○ 이 밖에도 김경수 (주)넥스트칩 대표이사 등 총 37명에게 대통령 표창(2명), 국무총리 표창(3명), 산업통상자원부장관 표창(32명)을 받았다.

< 반도체 산업발전 정부포상 대상자 >

구 분	훈 격		규모	비 고
정부 포상 (40점)	산업 훈장	은탑	1	이석희 사장(SK하이닉스)
		동탑	1	엄평용 대표이사((주)유진테크)
	산업포장		1	임용식 상무(삼성전자)
	대통령표창		2	김경수 대표이사((주)넥스트칩), 구용서 교수(단국대학교)
	국무총리표창		3	이재호 대표이사((주)테스), 김호식 사장((주)엘오티베큠), 윤종윤 부사장((주)엑시콘)
	장관표창		32	강병모 본부장(전자부품연구원) 등 32명

【참고 1】 제10회 반도체의 날 기념식 개요

【참고 2】 반도체의 날 정부포상자 명단

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전자부품과 이정남 사무관(☎ 044-203-4273)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1 제10회 반도체의 날 기념식 개요

□ 추진 배경

○ '08년부터 **10월 넷째주 목요일을 『반도체의 날』로 제정**하고, 반도체 산업 경쟁력 강화에 크게 이바지한 **유공자 및 공로자에 대한 포상 및 반도체 산·학·연의 노고를 격려하는 기념식 개최**

* '17년 포상 수여규모 : (훈장)2, (포장)1, (대표)2, (국표)3, (장관)32 등 총 40점

□ 행사 개요

○ 개최일시 : '17년 10월 26일(목), 18:00 ~ 20:00

○ 행사장소 : 서울 코엑스 인터컨티넨탈호텔 하모니볼룸(B1)

○ 초청인사 : 산업부 장관, 협회장 및 업계 CEO, 업계원로, 반도체산업 유공자 등 500여명

□ 행사 일정

시 간			세 부 사 항		비 고
17:30~18:00			**【식전행사】 VIP 환담 및 기념촬영**		VIP룸(B1, 모데라토)
18:00~18:45			**【1부】 기념행사**		하모니볼룸(B1)
18:00~18:02	(2')		- Opening 영상		-
18:02~18:03	(1')		- 개식 선언		사회자
18:03~18:05	(2')		- 국민의례		
18:05~18:08	(3')		- VIP 소개		
18:08~18:13	(5')		- 환영사		협회장(박성욱 SK부회장)
18:13~18:20	(7')		**- 반도체 상생협력 공동선언**		협회장 등
18:20~18:35	(15')		- **유공자 포상(정부 40점)** * 은탑훈장(1), 동탑훈장(1), 산업포장(1), 대통령 표창(2), 국무총리 표창(3), 산업부장관 표창(32)		산업부 장관
18:35~18:40	(5')		- **축사**		산업부 장관
18:40~18:50	(10')		- 유공자 포상(민간 22점)		협회장
18:50~20:00			【2부】 축하공연(만찬)		
18:50~18:55	(10')		- 축하공연 및 만찬개시		
18:55~19:00	(5')	만찬	- 건배 제의		주요VIP
19:00~19:15	(15')		- 경품 추첨		주요VIP
19:15~19:50	(35')		- 수상자 기념 촬영		
19:50~20:00	(10')		- 폐회		

최미화 / 홍보담당관 / 2017-10-26 11:15:48

참고 2 반도체의 날 정부 포상자 명단

□ **정부 포상** : 훈장(은탑1, 동탑1), 산업포장(1), 대통령표창(2), 국무총리표창(3), 산업부장관표창(32) 등 총 40점

훈격	소 속 직 급	성명	주요 공적
산업훈장(은탑)(1)	SK하이닉스 사장	이석희	▪ 10나노 및 20나노 DRAM개발 및 양산, 세계최초 최대 용량 서버용 메모리 개발 및 초저전력, 세계최대 용량 모바일 DRAM 개발
산업훈장(동탑)(1)	㈜유진테크 대표이사	엄평용	▪ 반도체 전공정 장비 국산화, 장비분야 세계 최초·최고 핵심 원천기술을 개발 - 3조원 이상의 수입대체 기여
산업포장(1)	삼성전자 상무	임용식	▪ 2006년 V낸드 기반기술(CTF) 연구, 10나노급 낸드 세계최초 상용화, 2017년 제4세대(64단) V낸드 본격적 양산화 성공
대통령표창(2)	㈜넥스트칩 대표이사	김경수	▪ 영상보안 카메라용 반도체 국산화, 2009년 이후 세계 시장점유율 2위를 달성
	단국대학교 교수	구용서	▪ 반도체설계분야 연구 및 우수 인력양성, 산업부 전력에너지반도체 기술개발사업 기획위원장 역임
국무총리표창(3)	㈜테스 대표이사	이재호	▪ 반도체 제조용 하드마스크 증착장비 국산화 성공, 3D 낸드플래시메모리 제조장비 개발 - 수입대체 3,138억원, 수출 1,379억원 발생
	㈜엘오티베큠 사장	김호식	▪ 반도체 산업의 필수 공정인 건식진공펌프 분야 기술 고도화 및 지속적인 인재육성, 신제품 개발을 통한 해외 시장 개척
	㈜엑시콘 부사장	윤종윤	▪ 메모리반도체(SSD) 개발, 반도체 검사장비 개발 국산화 성공 및 후공정 테스트장비 기술개발
산업부장관표창(32)	전자부품연구원 본부장	강병모	▪ 시스템반도체 산업기반 및 기술경쟁력 확보 노력, 국제산업 기술협력, 기술정책수립 및 국내 기업의 해외시장 진출지원
	강남대학교 교수	김구성	▪ 세계 최초 반도체 후공정 분야 패키징기술 개발 성공(Wafer Level Package), 정책사업 참여 및 상용화(벤처기업(이피웍스) 창업), 패키징 기술이전 및 확산 기여
	주성엔지니어링㈜ 부사장	김병철	▪ 반도체 제조장비의 국산화를 통해 국내 반도체 장비 산업 시장 확대, 원자층 증착을 이용한 차세대반도체 제조장비 개발 성공
	㈜동화자동화 대표이사	김석철	▪ 반도체 생산기기 자동화 및 핵심부품 국산화를 통한 생산성 향상에 기여, 생산시스템 컨트롤러와 네트워크를 통합·연계하여 비용절감 도모
	삼성전자 수석	김영대	▪ 국내최초 고성능 시스템반도체 개발 및 양산성공(LTE Modem), 사전 불량을 찾기 위한 테스트 전문가로 휴대폰 제조 및 신뢰성 제고를 통해 국가 수출확대에 기여
	㈜파인스 대표이사	김원영	▪ 국내 반도체 설계자산(IP) 산업의 선순환 생태계 구축, 디자인 서비스 산업강화를 통한 반도체 칩 설계 기간 단축, 원가절감, 품질 향상에 기여
	㈜실리콘마이터스 상무	김종환	▪ 시스템반도체 분야 신제품 개발을 통한 국가기술 경쟁력 제고, 국내최초 모바일 제품 Power IC(AMOLED EL용) 양산화에 성공
	㈜삼진쎈서 대표이사	김진석	▪ 반도체 장비분야 자동화 기술개발 및 타산업(디스플레이) 확산노력, 모션산업협회 회장 역임하며 반도체 산업 기반 확대에 기여
	㈜지니틱스 이사	김태영	▪ 시스템반도체 해외의존도가 높은 터치, 진동모터, 핀테크 IC의 국산화 성공, 국내 반도체 및 스마트폰 산업의 경쟁력 강화에 기여
	㈜이오테크닉스 전무	김희철	▪ 반도체 제조용 장비(Laser Marker, Wafer Marker, UV Laser Driller 등) 기술개발 및 개선에 기여
	SK하이닉스 수석	박찬하	▪ 메모리반도체 분야 제조 경쟁력 향상을 위한 혁신적인 포토마스크 공정개발(회로선폭 미세화에 따른 공정개선) 및 적용, 공정단순화와 원가절감 실현
	SK머티리얼즈㈜ 부장	박희만	▪ 반도체 제조용 핵심 소재인 특수가스(삼불화질소, 모노실란 등)의 국산화를 통한 수입 대체, 안정적 공급을 통한 산업 생산경쟁력 확보에 기여

try of Trade,
try and Energy

최미화 / 홍보담당관 / 2017-10-26 11:15:48

훈격	소 속 직 급	성명	주요 공적
	세메스㈜ 상무	서종열	▪ 반도체제조용 핵심장비(Etcher) 국산화, 지속적인 공정, 설비품질 향상을 통해 기술 경쟁력 제고에 기여, 협력사와의 공동기술개발을 통하여 동반성장을 위해 노력
	동국대학교 교수	송민규	▪ 국내 시스템반도체 설계분야(아날로그 회로설계) 연구개발을 통한 원천기술 확보 및 전문설계 인력양성을 위한 전문서적 출판, 강의를 통해 산업기반 구축에 기여
	AP시스템㈜ 부장	양현용	▪ 반도체산업 인적자원 개발 협의체 활동을 통해 고급인력 양성 노력, 산·학·연 연계를 통한 협력의 장 마련을 통해 산업 활성화에 기여
	서경대학교 교수	이광엽	▪ 차세대 마이크로프로세서 연구개발 및 국산화 성공, 산학협력 활동을 통해 자율주행 자동차 및 운전자 보조시스템용 시스템반도체 개발 성공
	㈜테라세미콘 부장	이승호	▪ 반도체 생산 핵심기술인 열처리, 증착 장비의 공정개발을 통해 미세화, 고집적화 공정에 대응 가능한 기반기술 구축에 기여, 협력사와 공동개발을 통한 상생협력 노력
	피에스케이㈜ 수석연구원	이욱	▪ 반도체 제조용 장비를 제어하는 소프트웨어 국산화를 통해 수입 대체 기여, 차세대 반도체 제조(450mm)용 장비 소프트웨어 세계 최초 개발
	삼성전자 수석	이정봉	▪ 스마트폰용 디스플레이 드라이버 시스템반도체 국산화를 통해 대용량 이미지 전송 및 전력소모 감소로 스마트폰 사용시간 대폭 증가시키는데 기여
	㈜우노실리콘 대표이사	임성묵	▪ 세계 최초로 비디오·오디오 통합 시스템반도체를 개발하는데 성공, CCTV용 영상압축 및 화면분할 칩 개발을 성공, 현재 음파통신, 음성인식을 위한 시스템 반도체 개발에 성공하였으며 양산단계에 있음
	에이에스엠엘 코리아㈜ 상무	임정규	▪ 반도체 제조용 핵심장비(노광장비) 연구개발을 통한 환경·안전확보에 노력 및 소재(Leadframe) 및 부품(Automatic Reticle Transfer) 국산화를 통한 수입 대체에 기여
	에스케이실트론㈜ 부장	전대현	▪ 메모리반도체용 실리콘 웨이퍼 제조 기술 연구개발 및 양산 성공, 웨이퍼 제조를 위한 잉곳 제조장비 국산화를 통한 기술 경쟁력 제고

훈격	소 속 직 급	성명	주요 공적
	㈜뉴파워프라즈마 이사	임은석	▪ 반도체 제조공정 중 세정을 위한 핵심 장비(RPG(Remote Plasma Generator)) 국산화 성공 및 관련 부품 국산화를 통한 원가 경쟁력 제고에 기여
	서울과학기술대학교 교수	좌성훈	▪ 국내 반도체 표준위원회 위원장으로 반도체분야 국제표준을 주도하여 국내 반도체 산업의 위상을 국제적으로 제고, 국가 반도체 관련 중장기 기술로드맵을 수립하고 확산하는데 기여
	호서대학교 교수	채상훈	▪ 국내 시스템반도체산업 저변확대를 위해 노력하였으며, 특히 초고속 광통신 모듈용 시스템반도체 연구, 주파수 합성기 시스템반도체 설계 기술 등 다수의 원천기술 확보를 통한 관련 산업 기반강화에 기여
	㈜원익아이피에스 부장	최대준	▪ 반도체 생산설비(증착장비) 국산화 및 공정 능력 향상(공간구성, 디자인 개선 등)을 통한 생산성 극대화를 실현, 국내 반도체산업의 대외 기술 경쟁력 제고에 기여
	임크텍크놀로지 코리아㈜ 수석	홍성무	▪ 스마트폰 제조용 반도체 패키징 기술 연구개발을 통한 매출 확대에 기여, 관련 원천기술 확보를 통한 경쟁사 대비 기술적 우위를 차지 노력
	㈜아르고 대표이사	황재성	▪ 국내 중소 팹리스기업과 대기업간의 가교역할을 통한 시스템반도체산업의 상생협력 생태계 조성 노력, 반도체 설계자산(IP)의 국산화를 통해 국내 기술력 증진에 크게 기여
	㈜에이씨엔 이사	김규동	▪ 반도체 제조공정(DRY ETCHER)분야에서 해외기술을 접목하여 국내 반도체 제조공정의 기술력 향상에 기여, 산·학·연 협력을 통한 산업 생태계 조성 노력
	㈜신성이엔지 (단체)	선행개발실	▪ 반도체산업 기반기술(클린룸 분야) 연구개발을 통해 해외 기술에 의존해 오던 클린룸 핵심장비 국산화 성공, 지속적인 개선 기술 연구
	삼성전자 수석 (상생협력)	강태균	▪ 2007년부터 장비·재료 성능평가 전문 인력으로 활동, 반도체설비 및 핵심부품에 대한 기초평가를 통해 성능향상 및 반도체설비 양산화에 기여, 국내중소업체의 기술개발 및 국산화 활동 추진
	㈜동부하이텍 수석 (상생협력)	석가문	▪ 반도체장비 재료성능 평가사업 수행을 통해 반도체 설비 및 핵심부품에 대한 성능평가 및 성능향상, 기술지도를 통한 중소업체 기술경쟁력 제고 도모

try of Trade,
try and Energy

최미화 / 홍보담당관 / 2017-10-26 11:15:48